

# 高导热银胶

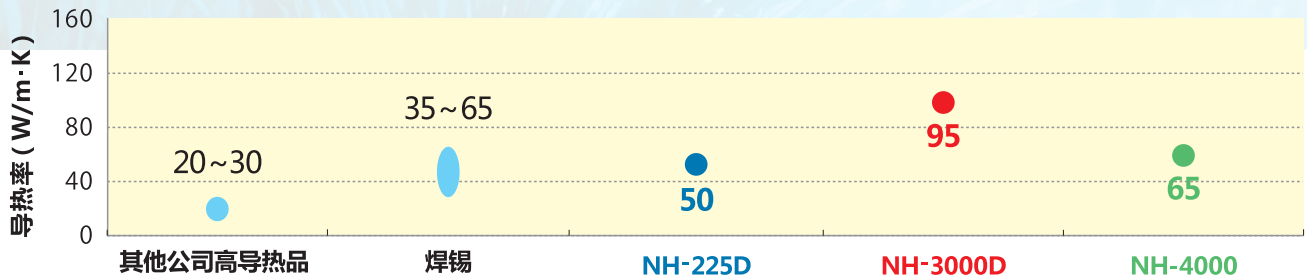
实现高导热性

NH系列、NPS-HB

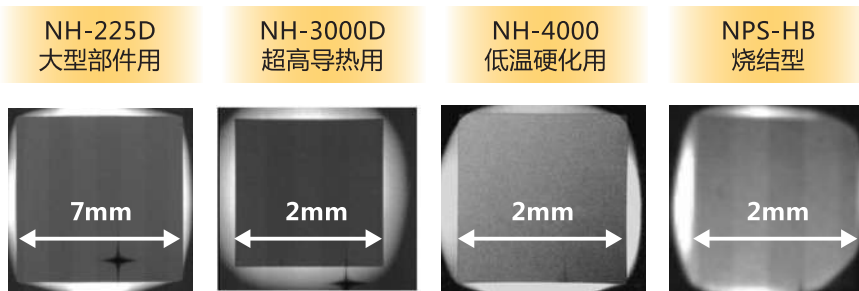
## 高导热银胶

有焊锡同等以上的高导热性银胶。适合高亮度LED功率晶体管等的放热。

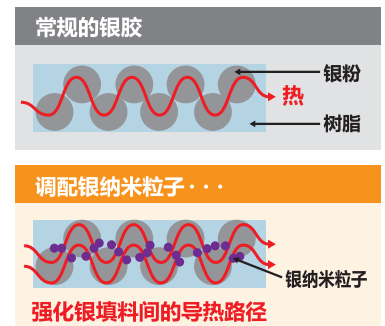
### 导热率的比较



### 可实现少气孔焊接 (X线透视图 图例)



### 高导热机理



### NH系列、NPS-HB的参数 (代表值)

项目	NH-225D	NH-3000D	NH-4000	NPS-HB	备注
特点	高导热、对应大型部件	高导热	低温硬化	烧结型, 高导热	
粘度	9 Pa·s	17 Pa·s	20 Pa·s	40 Pa·s	E型粘度计、25°C、5rpm
粘合剂	环氧树脂	环氧树脂	环氧树脂	-	
硬化条件	190°C × 90min	190°C × 90min	150°C × 90min	250°C × 60min	空气炉, 升温到所定温度后, 保持所定时间
体积固有电阻率	$2.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$1.2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$1.4 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$2.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$	
接合强度	室温	21 N/mm <sup>2</sup>	20 N/mm <sup>2</sup>	39 N/mm <sup>2</sup>	2mm□部件搭载平面剪切强度 基材的材质: 金, 银
	高温	3 N/mm <sup>2</sup>	13 N/mm <sup>2</sup>	8 N/mm <sup>2</sup>	
导热率	50 W/m·K	95 W/m·K	65W/m·K	249W/m·K <sup>(1)</sup> (参考值)	激光脉冲法 * 1) 周期加热法
玻璃转化温度	17 °C	15 °C	15 °C	不适用	DSC
适用部件	7mm□以下	2mm□以下	2mm□以下	2mm□以下	
涂布方法	针转移, 点胶	针转移, 点胶	针转移, 点胶	针转移, 点胶	

\* 1) 周期加热法: 依据ISO 22007-3